

プレスリリース

DMP の先端グラフィックス IP が富士通セミコンダクターの SoC プラットフォームに採用される

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル(本社: 東京都武蔵野市、東証マザーズ: 証券コード 3652、代表取締役 C.E.O. 山本達夫、以下 DMP)は、富士通セミコンダクター株式会社の ARM コア搭載 SoC(System on Chip)評価チップ「MB8AC0300」に DMP のグラフィックス IP コア SMAPH[®]-S、SMAPH-F 及び PICA[®]200 Lite が採用されたことを発表しました。

業界トップクラスの低消費電力性と高速性を誇る DMP の PICA/SMAPH グラフィックス IP 製品シリーズが、富士通セミコンダクター(株)の最新 ARM コア搭載 SoC 評価チップ「MB8AC0300」に採用されることで、業界標準のグラフィックス仕様である OpenGL ES 2.0、OpenGL ES 1.1 及び OpenVG 1.1 に対応した次世代 SoC 開発に向けた評価を可能とします。本評価チップを構成するプラットフォームは、デジタルコンシューマー機器から、プリンター、産業機器までを含む幅広い組込みシステムにおいて、ASIC をはじめとした先端 SoC による次世代グラフィックス・システムの設計を一段と容易にします。

本評価チップを搭載した評価ボードは、11月16日～18日にパシフィコ横浜で開催される「Embedded Technology 2011/組込み総合技術展」の DMP 展示ブース(ブース番号 B-01)と富士通セミコンダクター(株)展示ブース(ブース番号 D-32)にて展示される予定です。

【富士通セミコンダクター(株) SoC 評価チップ「MB8AC0300」の特徴】

- ・ ARM コア/周辺 IP/P.F の評価が可能(A9、R4F、M3、GPU、USB3.0、PCIe、SATA、GMAC 他)
- ・ デバイス(SoC)の完成前に OS 搭載、I/O ドライバ開発が可能
- ・ ユーザロジックを含めた評価が可能(別途、拡張 FPGA ボード要)

###

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル(DMP)について

2002年7月の会社設立以来、DMP(東証マザーズ: 証券コード 3652)は日本発のリーディング・テクノロジー・カンパニーとして、主に組込み市場向けに最適な 3D グラフィックス技術の開発を続けています。幅広い組込み製品をカバーするハード、ソフトを含む 3D グラフィックス・ソリューションにより、新しいユーザー体験を提供する事を目指しています。また Khronos グループのメンバーとして OpenGL ES の仕様策定に主導的役割を果たすほか、日本で唯一の OpenGL ES プログラミング・トレーニングを実施しています。DMP に関する情報は <http://www.dmprof.com/> で入手できます。

DMP の先端グラフィックス IP コア PICA/SMAPH シリーズについて PICA200 Lite

PICA200 グラフィックス IP コアは、アミューズメント、車載システム、携帯電話、ゲーム機、デジタル家電など、今後急成長が期待される「21 世紀のデジタルコンシューマー市場」向け ASIC/ASSP/SoC (System on a Chip)アプリケーションの幅広い要求を満たすために、柔軟でスケラブルな革新的ハードウェア・アーキテクチャを実現した、組込みシステム向け 3D グラフィックス IP コアです。OpenGL ES1.1 に対応しています。

SMAPH-S

SMAPH-S は、モバイル機器、デジタル家電、車載機器、アミューズメント機器などに搭載される ASIC/ASSP/SoC アプリケーションの幅広い要求を満たすために、プログラマブルシェーダ機能を搭載した高性能かつ低消費電力の 3D グラフィックス IP コアです。OpenGL ES2.0 に対応しており、OpenCL も対応を予定しています。用途に応じてジオメトリ処理プロセッサおよびフラグメント処理プロセッサを合計最大 24 個搭載可能

です。OCP-IP、AMBA AXI 標準バスインターコネクトに対応し、メモリインターフェイスのキャッシュ構造を最適化するなど、SoC 設計にフレンドリーなアーキテクチャを採用しています。

SMAPH-F

SMAPH-F は、独自の H/W 実装技術により、高速・高品質な描画を実現したベクターグラフィックス IP コアです。OpenVG1.1 に対応しています。SMAPH-F をデジタル家電、車載表示装置、モバイル機器、その他の広範囲な組み込み機器のディスプレイ用 ASIC/ASSP/SoC に搭載することにより、高性能かつ高品位な GUI(Graphical User Interface)アプリケーションを低消費電力かつ低コストで実現することができます。

SMAPH-H

SMAPH-H は、高性能かつ高品位の UI(User Interface)アプリケーション向けに機能を最適化した、OpenVG 1.1 および OpenGL ES 1.1 対応のハイブリッド IP コアです。描画性能を維持した上でベクターと 3D で共通するコンポーネントを共有することにより、回路規模と消費電力の低減を実現。高解像度でも画像劣化しないベクターグラフィックスのメリットと、視点の自由なコントロールや奥行きを利用した圧倒的なビジュアル演出が可能な 3D グラフィックスのメリットを併せ持つ、業界初のモバイル・コンシューマ向けソリューションです。

©2011 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル

DMP、DMP ロゴ、PICA、および SMAPH は株式会社デジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル 広報担当:桐井/IR 担当:伊藤

TEL:0422-60-3480 e-mail:info_06@dmprof.com

Web サイト: http://www.dmprof.com/company/inquiry_form/